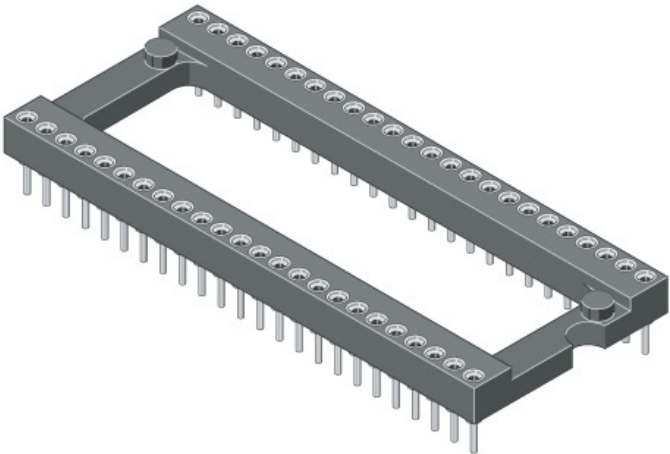
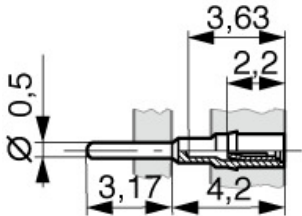




Raster (mm)	1,778 Shrink dip
Steckbar mit (von, bis)	ø 0,40-0,56
	■ 0,25x0,45
Polzahl	64
Buchse / Stift	Buchse
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Sn
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Bemessungsstrom IEC	3,0 A
Nennspannung	150 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	1000 V RMS für 1 Minute
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	2
Reihenabstand (Code)	700 mil
Kontakttyp	Standard Shrink



Veredelung Kontaktfeder	Au
Reihenabstand (mm)	19,05
Material Kontaktfeder	Beryllium Kupfer
Sockellayout	■ DIL (Dual-in-line)
Typ	IC Sockel
Verpackung	Standard
A	57,30
B	21,50
C	14,25

